

經濟部中小企業處 書函

機關地址：臺北市羅斯福路2段95號3樓
聯絡人/聯絡電話：游雅涵 (02)23680816#221
電子郵件：yhyou@sme.gov.tw
傳 真：(02)23673883

54050

南投市中興路669號5樓

受文者：南投縣中小企業服務中心

發文日期：中華民國112年3月9日

發文字號：中企輔字第11200121500號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（請至附件下載區下載附件，附件下載網址：

<https://bbs.moeasmea.gov.tw/SMEAppendix/AppendixDown.aspx>【登入序號：000747】）

主旨：函轉國家科學及技術委員會「2023台灣創新技術博覽會－未來科技館」辦理之TIE Award徵件訊息（如附件），請協助轉知並鼓勵企業踴躍報名參展，請查照。

說明：依據國家科學及技術委員會112年3月7日科會產字第1120013762號函辦理。

正本：各縣市中小企業服務中心、各縣市工業會

副本：

經濟部中小企業處